



**I moduli MOSFET al SiC di Toshiba consentono di miniaturizzare le applicazioni industriali aumentando contemporaneamente i livelli di efficienza**

**Düsseldorf, Germania, 17 Marzo 2021** - Toshiba Electronics Europe GmbH ("Toshiba") ha sfruttato le proprie competenze tecnologiche nei processi a semiconduttori a banda larga (WBC) per introdurre un modulo MOSFET compatto ma efficiente. Il nuovo MG800FXF2YMS3 incorpora dispositivi MOSFET da 3300V a doppio canale al carburo di silicio (SiC) in grado di supportare correnti da 800A. Le principali applicazioni di questi moduli ad alta densità di potenza includono gli azionamenti industriali, le apparecchiature per il controllo dei motori, gli inverter di potenza per i siti di generazione di energia rinnovabile, e i convertitori/inverter necessari per l'infrastruttura elettrica in ambito ferroviario.

Fondamentale per gli ottimi parametri di prestazione dei nuovi moduli MOSFET SiC di Toshiba è la tecnologia di packaging proprietaria dell'azienda. Gli alloggiamenti iXPLV (intelligent flexible package low voltage) impiegati in questi moduli si basano su un'avanzata tecnologia di connessione interna con sinterizzazione d'argento, che consente di ottenere alti livelli di efficienza in condizioni operative. È possibile supportare temperature di canale fino a 175°C, ed è inoltre garantito l'isolamento fino a 6000VRMS. Le perdite di commutazione all'accensione e allo spegnimento sono mantenute rispettivamente a 250mJ e 240mJ, con valori tipici di induttanza parassita previsti di appena 12 nH.

Per maggiori informazioni, visitate:

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/sic-mosfet-modules/detail.MG800FXF2YMS3.html>

###

## **Informazioni su Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Oltre alle unità HDD, il vasto portafoglio di prodotti della società comprende semiconduttori di potenza e altri dispositivi a discreti che vanno dai diodi ai circuiti integrati logici, ai semiconduttori ottici, oltre ai microcontrollori e ai prodotti standard specifici per un'applicazione (ASSP), tra gli altri.

TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di marketing, vendite e servizi logistici. Il presidente della compagnia è il sig. Tomoaki Kumagai.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

## **Indirizzo di riferimento per le pubblicazioni:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany  
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197  
Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)  
E-mail: [solution-marketing@toshiba-components.com](mailto:solution-marketing@toshiba-components.com)

## **Contatto per i giornalisti:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH  
Tel: +44 (0)193 282 2832  
E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

## **Comunicato emesso da:**

Birgit Schöniger, Publitek  
Tel: +44 (0) 1582 390980  
Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)  
E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

**Marzo 2021**

**Rif. 7326\_ITA**